



# 半导体行业点评：代工产线满载延续 新增产能将于 2022 年中后期落地



## 核心要点:

Q4 供需失衡尚未缓解，半导体晶圆代工产线持续满载运行，量价齐升助推龙头业绩上行延续；2022 年后半期产能扩张陆续落地 2021 年 Q4 半导体晶圆代工龙头产线维持满载状态，供需失衡延续引发量价齐升，晶圆代工龙头受益业绩持续上行。

晶圆代工厂投建的扩产产能预计于 2022 年中后期陆续投产，2022 年前半期行业供需失衡预计仍将延续，带动晶圆代工业务均价及营收上行。

根据 Trendforce 统计数据显示，今年新增产能主要分布在先进制程 3nm、5nm 及成熟制程 28nm，1Xnm 产能及 40/45nm-90nm 产能扩产有限或拉长供需紧张持续时间，为国内晶圆代工企业带来业绩增长。

## 投资建议

半导体行业供需失衡或延续至 2022 年中期，提振业内龙头业绩；中长期国产化替代加速，利好国内半导体龙头业绩、助推技术研发落地提速。

物联网、新能源汽车、数据中心等新兴需求增长拉动芯片市场需求，产业发展长期向好。建议重点关注功率半导体、晶圆代工等细分行业龙头。

建议持续关注半导体行业，维持行业增持评级。

## 风险提示

产能扩产不及预期；市场需求下滑；技术研发不及预期；上游成本增

幅超预期；宏观政策变化不及预期；系统性风险

关键词：新能源 新能源汽车 物联网 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_38651](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_38651)

